

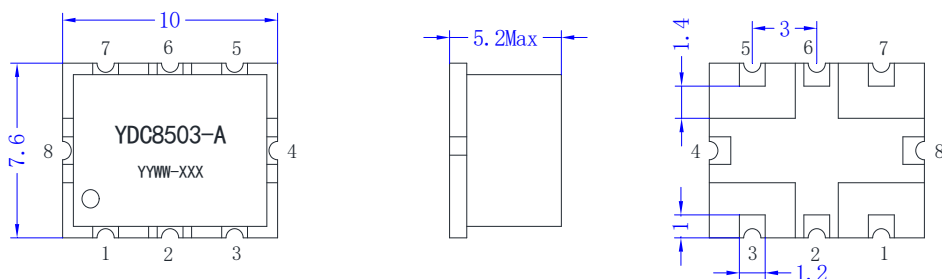
特点：

- 通带频率：30MHz~678MHz
- 插入损耗：≤0.5dB
- 耦合度：22.5±1dB
- 方向性：≥15dB
- 功率容量：50W
- SMT 封装
- 尺寸：10×7.6×5.2(Max)mm

性能参数：（50Ω系统， $P_{IN}=0\text{dBm}$ ， $T_A=-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ）

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
通带频率	f_c		30~678			MHz	
插入损耗	IL	$f=30\text{MHz}\sim 678\text{MHz}$			0.5	dB	
耦合度	Cou		21.5	22.5	23.5	dB	
方向性	Dir		15			dB	
输入驻波比	VSWR _i				1.5:1		
输出驻波比	VSWR _o				1.5:1		
耦合端驻波比	VSWR _c				1.5:1		

外形尺寸图：



注：1、单位：mm，未标注公差±0.3mm；
2、产品采用激光刻字标识。

引脚定义：

接口标识	符号	接口说明
1	RF IN	射频输入端口，DC 耦合
7	RF OUT	射频输出端口，DC 耦合
3	COUPLED	耦合输出端口，DC 耦合
5	50Ω TERM EXTERNAL	外接 50Ω 负载
2/4/6/8	GND	接地

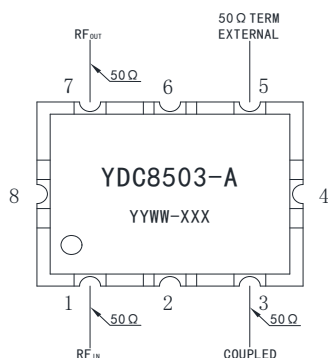
字符标志:

标识	说明	备注
YDC8503-A	产品型号	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

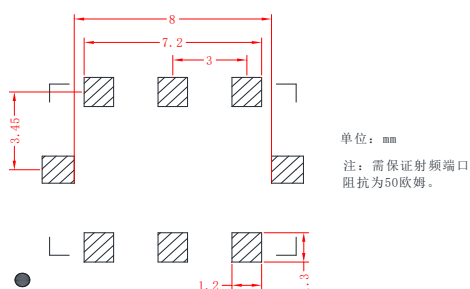
极限参数表:

参数名称	极限值
功率容量	50W
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55℃~+85℃
贮存温度	-55℃~+100℃

推荐外围电路:

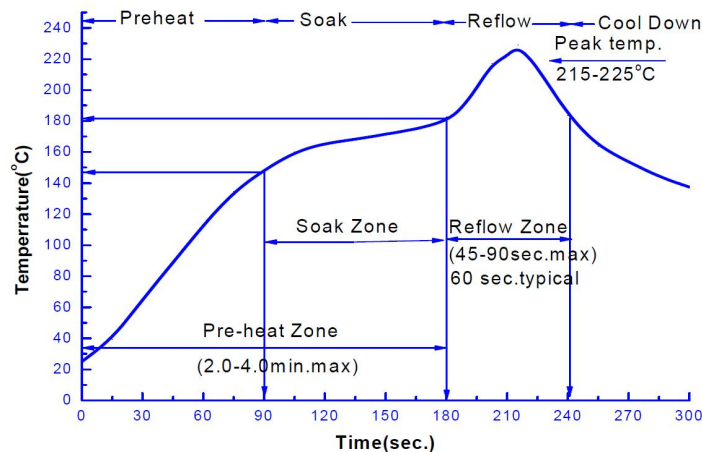


推荐焊盘:



产品使用注意事项:

- 产品在运输、装配使用过程中请注意保护引脚焊盘, 防止引脚焊盘受外界应力影响而出现污损、开裂及脱落等现象;
- 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点 183℃回流焊接, 回流温度推荐曲线:



防止内部焊料有二次重熔风险, 产品位置实测最高温度应小于 230℃。回流炉具体温度与时间的设置, 需用户根据整板产品实际大小进行调整。

- 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域), 为了保证连接良好, 底部引脚焊好之后, 需对侧面引脚进行补焊;
- 产品如果需要搪锡, 推荐加热台 170℃助焊, 烙铁 225±5℃辅焊。搪锡建议在 3-5 秒内完成, 去锡需在 5 秒内完成, 不能反复重复搪锡和去锡操作, 且搪锡后器件需自然冷却, 产品搪锡、焊接温度严禁超过 230℃, 超过限定温度。
- 产品禁止采用超声波清洗, 避免内部元器件及焊点受力出现开裂影响可靠性。
- 产品拆卸一般采用热台辅助加热, 热风枪局部加热方式。由于热风枪温度难以准确控制, 内部损坏几率较大, 经过拆卸的产品需谨慎使用。
- 产品在运输、装配使用过程中请注意防护, 产品应避免挤压碰撞、谨防高处跌落。

8. 产品在存储时需采用防静电袋及干燥剂进行密封包装，存放条件：温度-10~+40℃，相对湿度小于 80%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
9. 对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。